

12. Berliner Technologieforum

2. Juni 2022



Aktuelle Trends in der Elektronikfertigung new ways to go

Während unsere Gesellschaft und Industrie kontinuierlich mit neuen Herausforderungen wie Verfügbarkeit der Rohstoffe und Bauelemente, Logistik oder CO₂-Reduktion konfrontiert wird, schreitet die Umsetzung der Innovationen in den Bereichen der Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronikfertigung stetig voran.

Basierend auf der Teilnehmerumfrage des letzten Technologieforums haben die Veranstalter aus einer Vielzahl von Vorschlägen die Topthemen ausgesucht. Lassen Sie sich durch diese praxisrelevanten Vorträge inspirieren und Antworten auf aktuelle Fragen finden.

Das 12. Berliner Technologieforum stellt sowohl den Erfahrungsaustausch zu bereits gewonnenen Erkenntnissen als auch einen kurzen Ausblick auf die zukünftigen Trends der Elektronikfertigung in den Mittelpunkt.

Die Partnerfirmen Siemens, Rehm Thermal Systems, ASM Assembly Systems, ASYS Group, ATEcare, Balver Zinn, Christian Koenen, kolb Cleaning Technology, MTM Ruhrzinn, Vliesstoff Kasper und Zevac laden Sie herzlich am Donnerstag, den 2. Juni 2022 zum Berliner Technologieforum ein. Die Veranstaltung findet im Verwaltungsgebäude der **Siemens AG, Conference Center Berlin, Rohrdamm 85, 13629 Berlin** statt.



Programm 2. Juni 2022



12. Berliner Technologieforum

08.00 Uhr Einlass I Table Top Ausstellung

09.00 Uhr **Begrüßung und Moderation**
Bernd Müller, Siemens und Dr.-Ing. Paul Wild, Rehm Thermal Systems

09.15 Uhr **Schnittstellen der Zukunft – CFX/Hermes**
Thomas Marktscheffel, ASM Assembly Systems



09.45 Uhr **Praktische Erfahrungen mit Hermes bei der Inbetriebnahme & in der Produktion**
Martin Zistler, Zollner Elektronik



10.15 Uhr Kaffeepause

10.45 Uhr **Traut euch – Ausblicke in moderne Prüftechnologien**
Olaf Römer, ATECare



11.15 Uhr Spotlights – Kurzvorträge der Sponsoren zum Thema der Veranstaltung

12.30 Uhr Mittagessen I Table Top Ausstellung

14.15 Uhr **Neue Anwendungen für Sintern, TLP-Bonden und Klettwelding**
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wilde, IMTEK Institut für Mikrosystemtechnik



15.00 Uhr **Lösungen zur CO₂-Reduktion im Lötvorprozess**
Dr.-Ing. Paul Wild, Rehm Thermal Systems



15.30 Uhr **Alternative Erwärmungsverfahren für Leiterplatten und Baugruppen**
Dr.-Ing. Dirk Seehase, Universität Rostock



16.00 Uhr Gewinnspiel

16.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Hinweis: Alle Vorträge werden nach der Veranstaltung zum Download bereit gestellt

Anmeldung 2. Juni 2022



12. Berliner Technologieforum

über Rehm Thermal Systems, Annika Erhard

a.erhard@rehm-group.com

Für eine Teilnahme am 12. Berliner Technologieforum senden Sie einfach eine E-Mail unter Nennung aller Teilnehmer/innen und deren E-Mail-Adressen an oben aufgeführte E-Mail-Adresse. Anschließend erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Wir freuen uns mit Ihnen am 2. Juni 2022 ins Gespräch zu kommen!

Sollten Sie eine Übernachtung benötigen, können Sie selbst unter dem Stichwort „Techno“ ein Zimmer reservieren, in folgendem Hotel stellen wir ein Kontingent für Sie bereit.

ECONTEL HOTEL Berlin Charlottenburg
Sömmerringstrasse 24 – 26, 10589 Berlin
Comfort EZ 65,50 € / Nacht
inkl. Frühstück

Reservierungszentrale (bitte Hotelnamen mitangeben):
Tel.: +49(0)30 34681-0
Fax: +49(0)30 34681-063
Mail: berlin@econtel-hotels.de
www.amber-hotels.de

Das Kontingent steht bis zum 17. Mai 2022 zur Verfügung. Anschließend können Buchungen nur noch nach Verfügbarkeit vorgenommen werden.

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz-Grundverordnung

Ihre persönlichen Daten werden nur im Zusammenhang mit der Organisation des „12. Berliner Technologieforums“ erhoben. Durch die Zusendung einer Anmeldung per E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre angegebenen Daten an die Veranstalterfirmen (ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG, ATEcare Service GmbH & Co. KG, ASYS Group, BALVER ZINN Josef Jost GmbH & Co. KG, Christian Koenen GmbH, kolb CLEANING TECHNOLOGY GmbH, IMTEK Institut für Mikrosystemtechnik, MTM Ruhrzinn GmbH, Rehm Thermal Systems GmbH, Siemens AG, Vliesstoff Kasper GmbH, Universität Rostock, Zevac AG, Zollner Elektronik AG) weitergegeben werden dürfen. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft und Widerspruch sowie auf die Löschung Ihrer Daten.